

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年10月5日(05.10.2023)



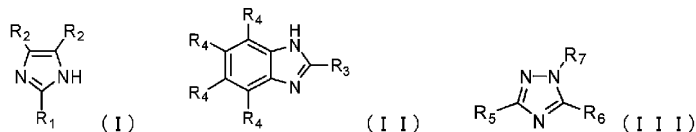
(10) 国際公開番号

WO 2023/190263 A1

- (51) 国際特許分類:
C23F 11/14 (2006.01) C22C 13/00 (2006.01)
B23K 35/26 (2006.01) C23C 22/52 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/012043
- (22) 国際出願日: 2023年3月24日(24.03.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-054331 2022年3月29日(29.03.2022) JP
- (71) 出願人: 四国化成工業株式会社 (SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION)
[JP/JP]; 〒7638504 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1 Kagawa (JP).
- (72) 発明者: 前 智也(MAE Tomoya); 〒7690202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁14番地1 四国化成工業株式会社内 Kagawa (JP). 吉成 光市(YOSHINARI Koichi); 〒7690202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁14番地1 四国化成工業株式会社内 Kagawa (JP). 中西 正人(NAKANISHI Masato); 〒7690202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁14番地1 四国化成工業株式会社内 Kagawa (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人栄光事務所 (Eikoh, P.C.); 〒1050003 東京都港区西新橋一丁目7番13号 虎ノ門イーストビルディング10階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: SURFACE TREATMENT AGENT FOR COPPER OR COPPER ALLOY

(54) 発明の名称: 銅または銅合金の表面処理剤



(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a surface treatment agent that exhibits excellent heat resistance of a chemical conversion film formed on a copper surface and ensures good solderability during soldering. A surface treatment agent for copper or copper alloy according to the present invention contains: an imidazole compound represented by chemical formula (I) or a benzimidazole compound represented by chemical formula (II); and a triazole compound represented by chemical formula (III). The definition of each substituent in chemical formulae (I)-(III) is the same as that defined in the specification.

(57) 要約: 本発明は、銅表面に形成される化成皮膜の耐熱性に優れ、半田付けを行う際には、良好な半田付け性が得られる表面処理剤を提供することを課題とする。本発明の銅または銅合金の表面処理剤は、化学式 (I) で示されるイミダゾール化合物または化学式 (II) で示されるベンズイミダゾール化合物と、化学式 (III) で示されるトリアゾール化合物を含有する。化学式 (I) ~ (III) 中の各置換基の定義は、明細書中の定義と同じである。

[続葉有]

WO 2023/190263 A1

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）